PR与innovus脚本调试方面：

1.与前端沟通协调全定制SRAM的需求，目前暂定从时序严格和可复用角度将定制器件数量压缩【刘婧恬】

2.学习DRC工艺手册，在S艺重新更新setup文件后重新跑PR，更换之前用错的lib库【刘婧恬】

3.配置S境，尝试对corel进行布局布线，目前跑到preplace阶段【刘婧恬】

4.完成RTL core\_l模块多corner逻辑综合，撰写逻辑综合结果分析报告【杨彬彬】

5.基于TL综合后网表推进PR脚本调试，debug route.tcl脚本【杨彬彬】

6.完成内部评测版simd码逻辑综合环境搭建【杨彬彬】

7.完成代码后端评估实施方案-逻辑综合部分初稿撰写【杨彬彬】

8.完成后端组拟招录工程师简历筛选【杨彬彬】

9.更新以β工程为基础的PR flow技术教学文档，添加部分innovus修复时序的内容【李峥】

10.整理并熟悉SMIC m DRC rule【李峥】

11.根据SMIC m DRC rule对β工程报出的DRC问题进行归档总结【李峥】

12.协助后端组卜苗苗工程师配置PT静态时序分析环境并讲解演示【李峥】

13.跑coreIflow，进行到place阶段，查看并分析时序环问题【胡梦恬】

14.整理并熟悉SMIC m DRC rule 【胡梦恬】

15.完成基于beta工程core\_l模块的布局布线流程【卜苗苗】

16.对PR流程及beta工程core\_l模块相关工作进行总结【卜苗苗】

17.在PT环境中查看关键路径时序并尝试优化【卜苗苗】

封装工作方面：

1.沟通明确塑封产出时间，更新时间节点【王贺】

2.明确裸片预留数量，首批塑封成品，其中板级调测试和机台测试暂定各【王贺】

3.对接陶封和机台测试，对后续计划、提供资料信息中的疑问等进行交互【王贺】

4.准备双周例会关于封装和测试内容的PPT，与就其中相关信息进行沟通交互【王贺】

5.组织进行联合攻关封测小组周例会【王贺】

6.推动进行封装标识设计【王贺】

7.DFT测试相关学习调研【桂羽】

8.与接信息【桂羽】

9.与芯片logo、芯片管壳标记设计方对接【桂羽】

10.封测试周例会并形成会议纪要【桂羽】

11.调研总结B芯片架构设计、模块信息等相关资料【邢玉婷】

12.调研芯片塑封、陶封及FCBGA技术资料，塑封芯片设计文档，包括BGA信息、设计说明、仿真报告等【邢玉婷】

13.对前期封装设计文件、仿真结果进行总结评估【邢玉婷】

14.安装封装设计软件，阅读塑封设计源文件【邢玉婷】

15.参与与封装与测试进度同步会【邢玉婷】

下周计划

PR与innovus脚本调试方面：

1.继续PR流程，优化route时序违例问题【刘婧恬】

2.整理calibre相关报错【刘婧恬】

3.继续推进PR脚本调试及debug【杨彬彬】

4.完成内部评测版simd码逻辑综合评估工作【杨彬彬】

5.继续进行β工程报出的DRC问题的归档总结【李峥】

6.根据新提供的tech lef，重新run一版绕线后的结果进行DRC验证【李峥】

7.报出C工程最新一版网表的时序环情况【李峥】

8.整理并熟悉SMIC m DRC rule【胡梦恬】

9.整理calibre相关报错【胡梦恬】

10.完成PT环境下时序的优化【卜苗苗】

11.基于beta工程core\_l模块GDS行calibre，并进行DRC检查【卜苗苗】

12.修复calibre报出的DRC违例【卜苗苗】

封装工作方面：

1.对接塑封装配工作，明确塑封芯片成品及裸片交接方式【王贺】

2.定版封装标识设计【王贺】

3.DFT测试相关学习调研【桂羽】

4.专利撰写【桂羽】

5.调研封装设计和仿真工具的使用【邢玉婷】

6.参与和FT对接塑封的生产与装配【邢玉婷】

7.调研多芯粒封装技术资料并形成报告【邢玉婷】